

烟台德邦科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：德邦科技

证券代码：688035

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(电话会议)
参与单位名称及人员姓名	国海证券、光大保德信基金、长江证券、上银基金管理有限公司、深圳盈游天下、千禧年投资
时间	2026年1月16-21日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事会办公室总监：战世能 公司证券事务代表：翟丞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司各业务板块占比情况？未来发展趋势如何？</p> <p>答：公司以集成电路封装材料技术为引领，聚焦集成电路封装、智能终端封装、新能源应用、高端装备应用四大应用领域。根据2025年半年度数据，集成电路板块占总收入的16.4%，智能终端板块占总收入24.2%，新能源板块占总收入的52%，高端装备板块占总收入的7.2%。从近两年各板块的增长趋势来看，集成电路和智能终端板块占比明显提升，新能源板块占比将呈现下降的趋势。</p>

2、请介绍一下公司集成电路业务具体产品情况？

公司集成电路封装材料具体产品包括：导热系列产品（导热垫片、导热凝胶、相变化材料 PCM、液态金属等）；固晶系列产品（芯片固晶胶 DAP、芯片粘接 DAF/CDAF 膜）；芯片封装用薄膜系列产品（UV 减薄膜、UV 切割膜）以及芯片底部填充材料、芯片框架 AD 胶等封装材料。

公司为集成电路（如 CPU、GPU、AI 芯片、光模块等）提供高性能导热界面材料，主要包括 TIM（TIM1、TIM1.5、TIM2）、导热硅脂、凝胶、相变材料及全球领先的凝胶垫片等系列产品，用于解决芯片与散热器间的热管理问题，确保器件稳定可靠运行。

芯片固晶胶，可以适用于多种封装形式，覆盖 MOS、QFN、QFP、BGA 和存储器等，客户包括通富微电、华天科技、长电科技等国内集成电路封测企业；晶圆 UV 膜方面，目前在华天科技、长电科技、日月新等国内集成电路封测企业批量供货。

芯片底部填充材料、芯片框架 AD 胶、芯片粘接 DAF/CDAF 膜等先进封装材料的突破和导入，均已实现了小批量的出货，获头部客户验证通过，市场前景广阔。

3 、请介绍一下公司底部填充胶、AD 胶、DAF 膜等先进封装材料目前竞争格局情况？

答：目前芯片底部填充材料、芯片框架 AD 胶、芯片粘接 DAF/CDAF 膜等先进封装材料国内仍处于起步阶段，

产品市场份额目前仍被日韩、欧美等国外厂商占据，国内具备验证或是导入能力的厂商很少。公司紧跟国产化进程的步伐，持续投入研发力量，已具备了产品量产能力，芯片底部填充材料、芯片框架 AD 胶、芯片粘接 DAF/CDAF 膜等几个品类的先进封装材料 2025 年已有小批量交付。我们也期待国产化进程的加速和客户的积极导入大批量使用。

4、请具体介绍一下公司导热界面材料业务情况？

答：公司导热界面材料目前已经成为公司重要的支柱业务之一，在收入、利润方面均有较大的贡献。公司导热界面材料主要由深圳德邦界面、苏州泰吉诺两个子公司负责，两个子公司在产品应用定位上略有区别。深圳德邦界面产品广泛应用于消费电子、汽车电子、存储、通讯、新能源等领域，并在汽车电子、存储等高附加值领域持续突破；泰吉诺产品主要应用于服务器领域，同时也应用于消费电子、汽车电子、通讯等领域。

5、国内热管理材料市场的竞争格局及公司的行业地位如何？

答：热界面材料是整个热管理系统的重要组成部分，目前国内做热界面材料的中小企业较多，但大部分仍处于相对低端的领域，高端热界面材料市场主要份额仍被国外厂商占据。

目前公司热界面材料已具备多品类、多系列产品及解决方案，公司凭借自主核心技术研发能力，目前已具备参与全球高端电子封装材料产业分工、参与竞争的综合实力。同时公司也在积极探索新的产品体系，进一步完善公司在热管理领域的布局。

6、请介绍一下泰吉诺主要产品及客户占比情况？

答：子公司泰吉诺是国内少数能提供全系列导热界面材料解决方案的厂商之一，也是国内导热材料行业国产化与技术升级的关键参与者，其主要产品包括高性能导热硅脂、导热凝胶、高导热凝胶垫片、相变材料及液态金属导热材料等，广泛应用于数据中心(AI 服务器/GPU)、新能源汽车（电池/BMS/电控）、消费电子等领域。泰吉诺的导热界面材料业务专注于为高算力场景提供散热解决方案。在 AI 领域，其高性能导热凝胶垫片、液态金属材料及相变材料，广泛应用于 AI 服务器、光模块、GPU/ASIC 芯片的散热，可有效应对高热流密度，保障核心算力部件稳定运行与性能释放，是保障 AI 基础设施热管理的核心组成部分。

目前，服务器领域的收入占泰吉诺整体收入一半以上，是目前泰吉诺贡献收入最大的应用领域。泰吉诺客户群体覆盖国内外头部设备制造商与国际终端品牌，产品已批量应用于国内外头部服务器厂商，从收入的角度看，目前国际客户占比相对较高，但随着国际地缘政治的影

响，国内 AI 领域被高速发展，国内下游热管理国产化需求显著提高，国内客户的需求呈现高速增长的趋势。

7、请介绍一下公司智能终端业务情况，主要的增长驱动力有哪些？

答：公司材料广泛应用于手机、耳机、手表、Pad、笔记本电脑、车载电子、平面显示等智能终端产品。目前在耳机端的应用已具备了一定的份额优势，其中在 TWS 耳机领域表现尤为突出----凭借在声学模组密封、结构粘接等环节的技术优势，已在国内外头部客户的供应链中占据较高市场份额，成为该细分领域的核心供应商之一；在智能手机端，以“LIPO 超窄边框屏幕封装技术”为代表的新的应用点不断突破，在智能手机端的应用点整体份额呈现不断增长的趋势；在车载电子端实现多点的导入和起量；在偏光片领域应用拓展迅速并快速起量。产品竞争力的提升带来的新的应用点的突破、份额的增长，推动了智能终端业务的高效增长。

8、公司新能源板块增长趋势如何？面对降价公司都有哪些应对措施？

答：随着下游新能源汽车销量的稳定增长以及储能业务的快速渗透，公司新能源应用材料出货量持续保持较高速度增长，市场份额较为稳定。但受制于下游行业降本的需求，公司新能源应用材料也受到降价的压力。面对

	降价，公司多方面推进降本措施，一是公司投建的行业最先进的智能化全自动生产线陆续达产，大幅降低了生产及运营成本，我们还将持续优化，推动极致降本工作；二是公司具备国内领先的产能、产量优势，在原材料集采方面具有明显的议价优势；三是公司会持续进行配方优化，技术降本。通过上述措施，公司努力实现新能源板块在销量增长的同时，毛利率稳定在合理的区间。
附件清单（如有）	无